



## FLASHPAK

业界最值得信赖的手动烧录器

人体工学设计-提高生产力

- 体积小
- 可同时对四个芯片进行烧录
- 压板设计
- 非常适合产品设计阶段或产量较小需求

一个操作员可以同时运行多个FlashPAK



FlashPAK III采用轻薄的人体工学设计，占用桌面空间小。这种设计使操作员能够轻松地同时运行多个FlashPAK，从而提高产能。独特的压板设计，可同时对四个芯片进行烧录。

DATA I/O 中国

上海市徐汇区平福路188号3号楼6楼

[www.dataio.cn](http://www.dataio.cn)

[ChinaSales@dataio.com](mailto:ChinaSales@dataio.com)

021-58867686

## 规格

- 4个编程插座 (1个编程器)
- 网络化运营
- 从主文件或数据文件加载
- 联动插座驱动
- 键盘、液晶显示器和状态LED
- PCMCIA卡读写器
- 小巧、轻便、便携的设计

•系统软件:	TaskLink for Windows
•网络接口:	RJ45 connector 需要 IP address
•烧录器	FlashCORE III with SuperBoost Technology
物理规格	
•宽度:	23.5 cm
•深度:	34 cm
•高度:	15 cm
•重量:	3kg

## 增值软件

- NAND Bad Block Schemes
- Serial Number Server
- Data Mapper
- Version Control

## 服务

- 一年质保
- **Annual programmer support (APS):** 系统价格已包含第一年服务支持的费用。Data I/O 同时为用户提供延长服务及涵盖软件及硬件的服务支持包(不包括消耗品)

## 适配器与器件支持

- 烧录技术: Standard burn-in socket (每个烧录座使用次数为5,000 - 10,000次)  
High Insertion Count Socket (HIC) 适用 BGA, TSOP, QFP (每个烧录座使用次数为250,000次)
- 器件支持: Flash Memory (NOR, NAND, MCP, MMC, e.MMC, SD, MoviNAND, OneNAND, iNAND, Serial Flash, EEPROM, EPROM 等), Microcontrollers 和 Logic devices (CPLD, FPGA's, PLD's) 等
- 封装支持: TSOP, BGA, QFP, TSOP2, FBGA, TQFP, CSP, uBGA, PLCC, SOIC, EBGA, PoP, SSOP, TFBGA 等
- 器件烧录和测试: Program, continuity, checksum, blank check, mis-insertion, test, verify, backwards device, two pass verify, ID check, Illegal bit-check

## PC工作站要求

- 操作系统: Windows 10
  - 硬盘空间: 最小90MB
  - 可选PCMCIA卡插槽: 用于工作卡
  - 网络接口
  - CD ROM Drive
  - Serial or USB mouse
  - 工作电压: 110 -240 VAC
  - 频率范围: 50-60 Hz
  - 功耗: 100 watts
  - 工作温度: +0°C to + 50°C
  - 运输温度: -4°C to +70°C
  - 储存温度: 0°C to +70°C
  - 湿度: 无凝结湿度小于70%
- 操作 正常的办公环境/电源